



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2019 年第二季自結財務報告

2019 年 7 月 30 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(30)日公告 2019 年第二季自結財務報告。

2019 年第二季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 44.51 億元，較前季增加 23%，較去年同期減少 3%
- ◆ 本季合併毛利率為 34.0%，較前季增加 9 個百分點；
本季營業淨利率 20.6%，較前季增加 12.3 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 9.18 億元，較前季增加 206%，較去年同期減少 3%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 7.74 億元，較前季增加 413%，較去年同期減少 15%；
每股盈餘為新台幣 1.87 元，前季為新台幣 0.41 元

2019 年第三季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 第三季營收預計較第二季成長 30% 上下。
- ◆ 第三季毛利率預計可望優於第二季的水準。

管理者評論

“2019年第二季穩懋營收達新台幣44.5億元，季成長率及年成長率分別為+23%及-3%，超過穩懋原先的預期，主要是因為亞洲的智慧型手機相關PA设计公司客戶自第一季末開始增溫且在第二季動能逐漸放大，再加上因應第三季智慧型手機終端新機發表的需求，相關客戶備貨開始啟動所致。上半年累積營收達新台幣80.7億元，雖然仍比去年同期減少約一成的水準，但在歷經了連續三季的產業低迷之後，六月營收年成長轉為正數等於正式預告了旺季的到來，而穩懋月產能也在季底達到36,000片，為旺季做好準備。穩懋產能利用率自第一季的50%上升到第二季的80%，使得第二季毛利率如預期的自第一季谷底翻升來到34%的水準。隨著毛利率上升，第二季營業淨利率來到20.6%的水準，EPS達到新台幣1.87元。

綜觀下半年，穩懋因長期佈局全球眾多fabless(無晶圓廠)客戶，將持續受惠。雖然今年至今發表的5G手機並不多，但是我們相信5G需求即將到來，隨著各國5G服務陸續上路，可望帶動更多智慧型手機製造商推出更多5G手機，穩懋與多個客戶的5G PA早已完成開發，今年上半年已有少量出貨。在此同時，我們已經先觀察到5G相關的基礎建設動能轉強，穩懋infrastructure的營收在上半年的年成長幅度已大於四成，下半年也不看淡。

展望2019年第三季，我們預計營收將較第二季成長30%上下，預計毛利率可望優於第二季的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於1999年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路设计公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及3D感測領域中，穩懋更以MMIC生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。